

プリント配線基板・セラミック基板への接合めっき技術①

The latest plating technology of

各種無電解めっきの特徴

特徴	フラッシュ金めっき			厚付け金めっき			パラジウム-金めっき		銀めっき	スズめっき
	弱酸性	中性	中性	弱アルカリ性	中性	弱酸性	Pd	Au		
pH	弱酸性	中性	中性	弱アルカリ性	中性	弱酸性	弱酸性	弱酸性	弱酸性	酸性
析出法	置換	置換	置換	自己触媒	自己触媒	置換	自己触媒	置換	置換	置換
シアン使用	有	有	無	有	無	有	無	有	無	無
選択析出性	◎	○	◎	○	△	◎	○		◎	◎
基板ダメージ	△	◎	○	○	◎	×	○		○	△
下地金属腐食	○	◎	○	◎	◎	×	◎		○	○
半田付け性	◎	◎	◎	○	○	○	◎		○	○
ボンディング性	×	○	×	○	○	△	◎		○	△
めっき浴安定性	◎	○	○	○	△	◎	○		○	○
めっき液コスト	◎	○	△	○	△	○	○		○	△



清川メッキ工業株式会社 Kiyokawa Plating Industry Co., Ltd

本社 〒918-8515 福井市和田中1丁目414 TEL(0776)23-2912 FAX(0776)21-7402

E-mail info@kiyokawa.co.jp

www.kiyokawa.co.jp